

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2024-024

锦州神工半导体股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2023/8/18，由董事长潘连胜先生提议
回购方案实施期限	待第二届董事会第十五次会议审议通过后 12 个月
预计回购金额	1,500.00 万元~3,000.00 万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	950,416 股
累计已回购股数占总股本比例	0.5579%
累计已回购金额	28,595,409.90 万元
实际回购价格区间	14.70 元/股~35.12 元/股

一、回购股份的基本情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）。公司拟回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过 44.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含），同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司 10 月 31 日及 11 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《锦州神工半导体股份有限公司关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 950,416 股，占公司总股本 170,305,736 股的比例为 0.5579%，回购成交最高价为 35.12 元/股，最低价为 14.70 元/股，支付的资金总额为人民币 28,595,409.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2024 年 5 月 1 日